

描述 / Descriptions

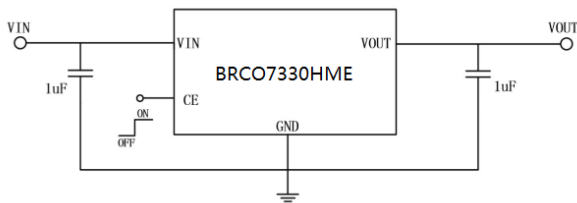
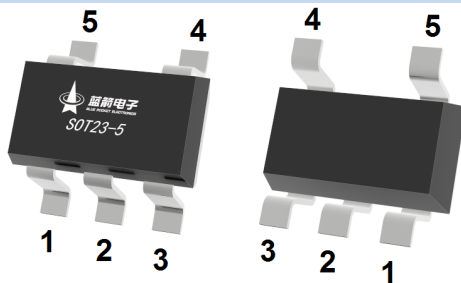
BRCO7330HME 是一款采用 CMOS 工艺实现三端高输入电压、低压差、低功耗的线性稳压器。它的输出电流达到 300mA，最大输入电压可达到 30V。芯片采用 CMOS 工艺可实现低压差和小静态电流。

特征 / Features

- ◆ 输入极限耐压达30V
- ◆ 稳态输出电流300mA
- ◆ 低压差，200mV@Iout=100mA
- ◆ 低静态功耗，典型值2.5μA
- ◆ 小温度系数，±50ppm/°C
- ◆ 高精度，±2%
- ◆ 高PSRR：65dB@1kHz
- ◆ SOT23-5封装，无卤产品

用途 / Applications

- ◆ 电池供电设备
- ◆ 通讯设备
- ◆ 便携式设备

典型应用电路图 / Typical Application**引脚排列 / Pinning**

引脚	名称	功能	引脚	名称	功能
1	V _{IN}	电压输入端	4	NC	悬空
2	GND	电源地	5	V _{OUT}	电压输出端
3	CE	使能端，不能悬空使用，高电平有效			

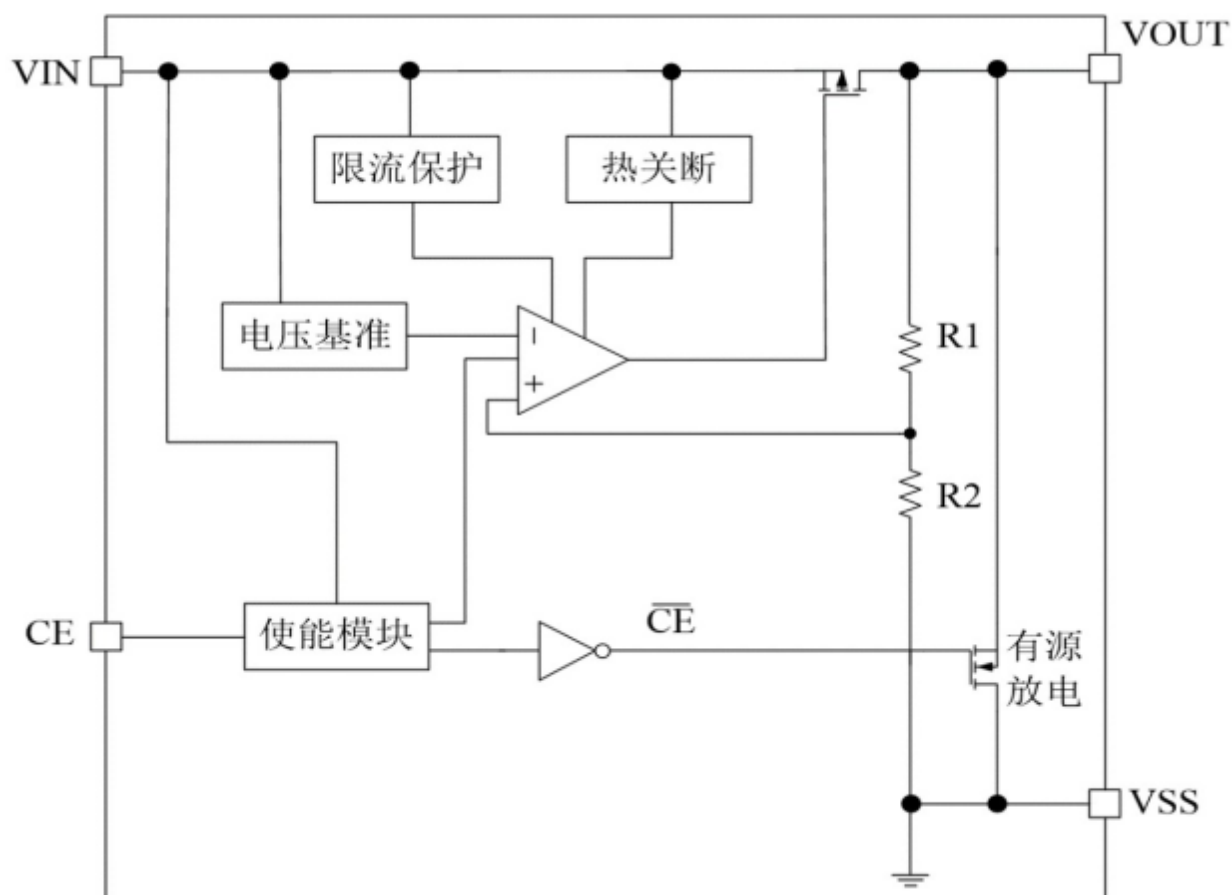
极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数	符号	数值	单位
输入极限电压	V_{IN_MAX}	30	V
输入工作电压	V_{IN}	-0.3~30	V
CE引脚耐压	V_{CE}	$V_{IN}-0.3 \sim V_{IN}+0.3$	V
输出电流	I_{OUT}	0~500	mA
耗散功率	P_D	0.3	W
储存温度	T_{stg}	-40 to +150	°C
工作温度	T_{OP}	-40 to +85	°C

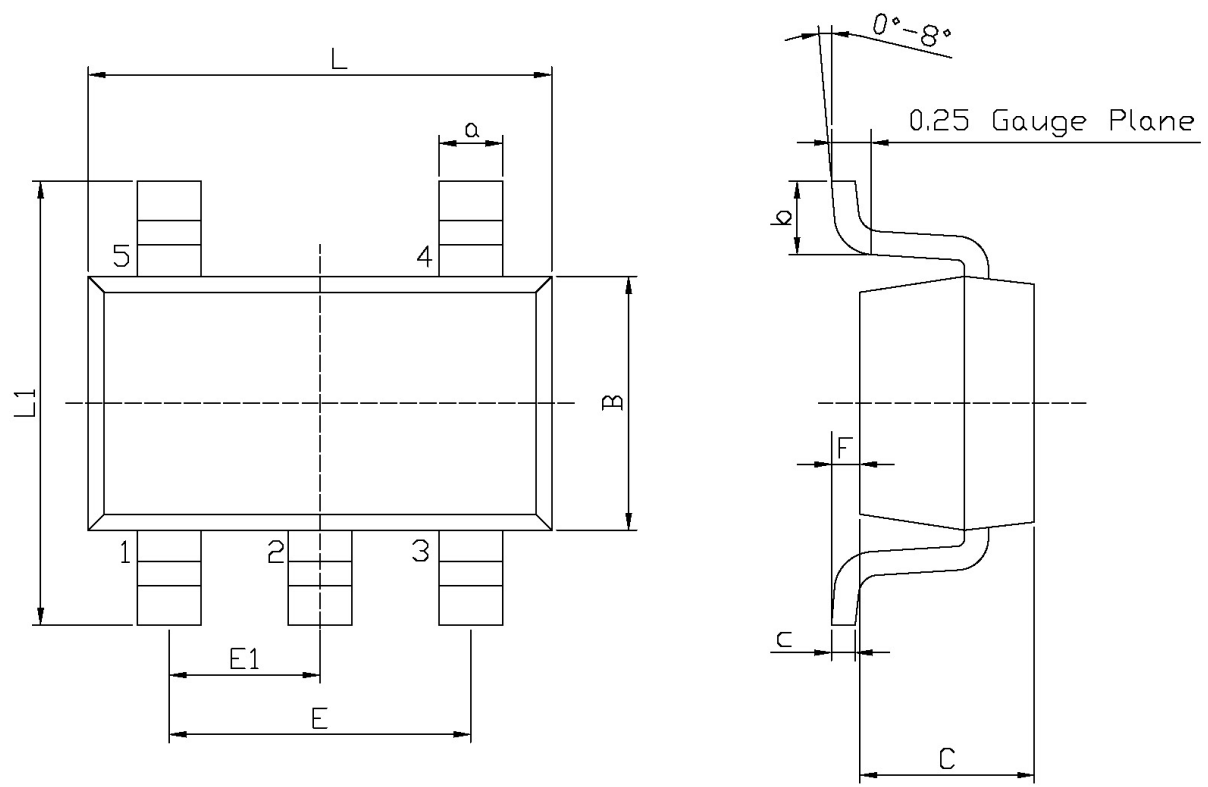
电性能参数 / Electrical Characteristics(T_A=25°C, V_{IN}=V_{OUT}+1V, C_{IN}=C_{OUT}=1uF, unless otherwise specified)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	V_{IN}		2.5		24	V
输出电压	V_{OUT}	$I_{OUT}=10mA$	$V_{OUT} * 0.98$		$V_{OUT} * 1.02$	V
静态工作电流	I_{SS}	$I_{OUT}=0mA$	-	2.5	6	uA
停机电流	I_{ST}	$CE=0V$			0.2	uA
输出限流	I_{LIM}	-	500			mA
输入输出压差	V_{DROP}	$I_{OUT}=100mA$	-	200	-	mV
短路电流	I_{SHORT}	输出短路		55		mA
使能低门限	V_{CE_L}				0.4	V
使能高门限	V_{CE_H}		1.5			V
放电电阻	R_{DIS}	$V_{CE} < 0.4V$		350		Ω
负载调整率	ΔV_{LOAD}	$V_{IN}=V_{OUT}+1$ $1mA \leq I_{OUT} \leq 100mA$	-	5	20	mV
线性调整率	ΔV_{LINE}	$I_{OUT}=10mA$ $V_{OUT}+1V \leq V_{IN} \leq 20V$	-	0.05	-	%/V
输出电压温度系数	$\frac{\Delta V_{OUT}}{(\Delta T_A * V_{OUT})}$	$I_{OUT}=1mA$ $-40^\circ C \leq T_A \leq +85^\circ C$	-	±50	-	ppm/°C
电源纹波抑制比	PSRR	$V_{IN}=4.3V$ $f=100Hz$	-	80	-	dB
		$V_{OUT}=3.3V$ $f=1kHz$	-	65	-	
		$I_{OUT}=10mA$ $f=10kHz$	-	50	-	
热关断温度	T_{SD}	温度上升	-	160	-	°C
热关断迟滞温度	ΔT_{SD}	温度下降	-	25	-	°C

功能框图 / Functionl Block Diagram



外形尺寸图 / Package Dimensions



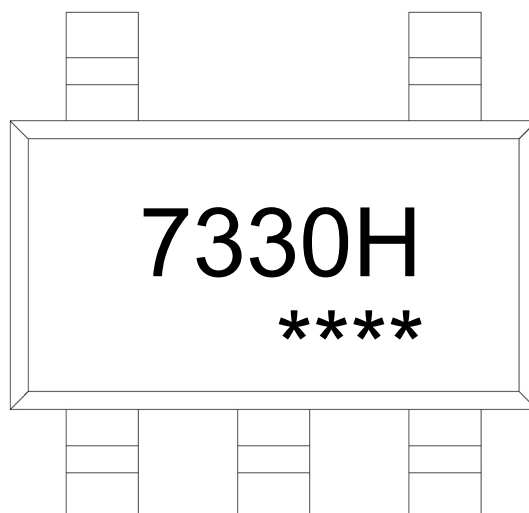
Unit: mm

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
L	2.82	3.02	E1	0.85	1.05
B	1.50	1.70	a	0.35	0.50
C	0.90	1.30	c	0.10	0.20
L1	2.60	3.00	b	0.35	0.55
E	1.80	2.00	F	0	0.15

SOT23-5



印章说明 / Marking Instructions

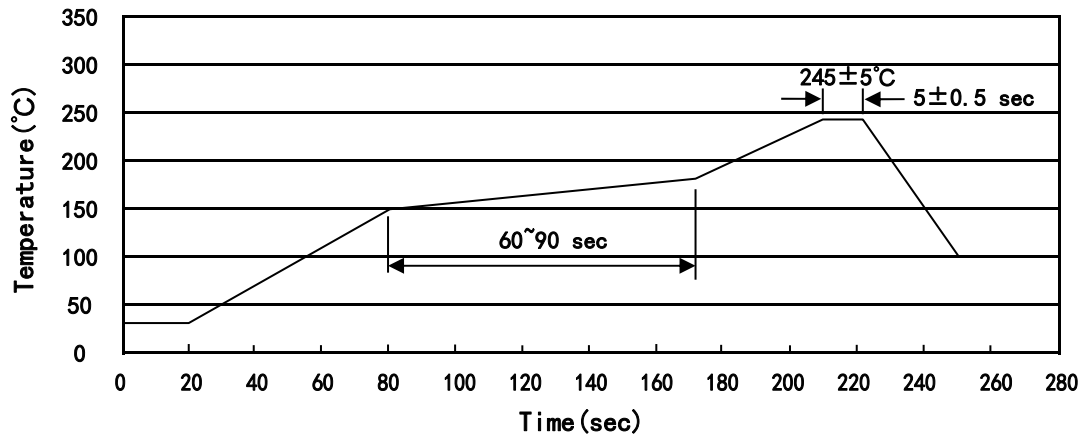


说明：

7330H：为型号代码

****：为生产批号代码，随生产批号变化

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 150~180°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:150~180°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT23-5/6	3,000	10	30,000	4	120,000	7" ×8	210×205×205	445×435×230

使用说明 / Notices

本文档中提供的所有信息均受法律免责声明的约束。

All information provided in this document is subject to legal disclaimers.